

电子元器件及半导体制造业促进计划 (SPECS)

1. 背景

政府高度重视电子硬件制造，因为它是印度政府“印度制造”和“数字印度”计划的重要支柱之一。印度的电子制造业目前面临着8-10%的残疾，与电子制造业不同部门以及价值链不同阶段的竞争经济体相比。

1.2 过去几年，国内电子产品制造业大幅增长，正稳步从半淘汰 (SKD) 水平向完全淘汰 (CKD) 水平转变。然而，国内附加值仍然很低，仅在10-30%之间。这是由于国家电子元器件制造生态系统的缺失、半导体制造生态系统的近乎缺失和显示器制造生态系统的缺失。国内电子制造业主要增长是进口电子元器件/分总成/零部件的成品组装，主要满足国内需求。

1.3 发展供应链是制造高附加值电子产品的关键。2019年2月25日公布的2019年国家电子政策 (NPE 2019) 愿景是，通过鼓励和推动印度发展核心部件 (包括芯片组) 的能力，将印度定位为电子系统设计和制造 (ESDM) 的全球枢纽，为该行业创造一个有利于全球竞争的环境。

1.4 电子元件和半导体的制造是资本密集型的，必须应对不断变化的技术。零部件是电子产品的核心，是物料清单 (BOM) 总价值的重要组成部分。一个充满活力的电子元件制造生态系统对于印度电子制造业的整体长期和可持续增长以及实现国际收支净正平衡至关重要。

1.5 **吸引投资制造电子元件/半导体的主要障碍包括“零”关税进口**，因为大多数电子元件/半导体都在世贸组织《信息技术协定》（ITA-1）的范围内；**建立具有竞争力的全球规模能力所需的高资本成本**；基础设施不足；缺乏充足、可靠和高质量的电力以及具有竞争力的供水；缺乏供应链；物流成本高；缺乏技术等。

1.6 **修改后的特别激励计划（M-SIPS）旨在提供财政激励**，帮助抵消残疾和高昂的前期成本，从而吸引电子制造业的投资。该计划开放至2018年12月31日，接受新项目和扩建项目的申请。该计划为投资电子制造设施的资本支出提供补贴（经济特区单位占20%，非经济特区单位占25%）。（M-SIPS）在促进印度电子制造业投资方面发挥了重要作用。

2. 电子元器件及半导体制造业促进计划（SPECS）

2.1 **根据《促进电子元件和半导体制造计划》（SPECS）**，拟按构成电子产品供应链的附表，提供25%资本支出的财政激励，用于制造商品。

3. 目标

3.1 该计划将有助于抵消国内零部件和半导体制造业的残疾，以加强该国的电子制造生态系统。。

4. 资格

4.1 **SPECS将适用于对新装置的投资**，以及扩大现有装置的能力/现代化和多样化。。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

电子信息技术部

(IPHW 部门)

5. 阈值限制

5.1 附加了符合该计划要求的最低门槛投资.

5.2 新机组或扩容/现代化和现有机组多样化的门槛相同。

5.3 对于提供激励措施的货物/阈值清单的变更（如有），将进行定期审查.

6. 计划的任期

6.1 SPECS将自通知之日起3年内开放申请。本计划所接获的申请将持续评估，并会按照本计划所给予的批准继续实施.

7. 该计划下的激励措施

7.1 对按附表所列货物投资单位，给予资本性支出25%的奖励。奖励将在报销的基础上提供。

7.2 资本支出将是工厂、机械、设备、相关公用设施和技术（包括研发）的总支出。这些合格资本支出的详细情况将列入准则。翻新厂房、机械和设备（包括相关公用设施和研发）的总价值，无论是进口的还是国内采购的，不超过总合格厂房、机械和设备（包括相关公用设施和研发）的20%，应考虑计算这方面的激励.

7.3 州政府或其任何机构或地方机构提供的激励（如有）应超过拟议方案中的合格激励。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

电子信息技术部

(IPHW 部门)

7.4 申请人也有资格根据印度政府的任何其他计划领取福利。然而，申请人在（M-SIPS）计划下承诺的投资，如已申请奖励，则不符合 SPECS 计划下的合格投资资格。

8. 批准和支付流程

8.1 任何在印度注册的实体均可根据该计划提出申请。

8.2 每一项申请都将被视为新的投资，并将被视为一项独立的申请。申请只适用于单期工程，本计划不考虑分期申请。对任何申请人提出多个申请和/或多个地点没有限制。

8.3 一份在各方面均已完成并在计划到期日前提交的初步申请，将持续评估，并考虑批准。

8.4 本计划下的奖励将自申请确认之日起生效。确认书将在对申请进行初步审查后发出。对申请的确认不应解释为根据SPECS批准

8.5 奖励将在收到申请之日起5年内用于投资。

8.6 对符合条件的资本性支出的奖励，经申请批准后予以释放，但资本性支出超过门槛值的，开始商业化生产。随后的奖励索赔可每六个月提交一次。

8.7 根据规范获得激励的单位必须在商业生产中至少保留3（三）年，从开始生产之日起，或从收到上次激励之日起1（一）年，以较晚者为准。

9. 治理机制

9.1 该计划将通过一个节点机构实施。节点机构将对申请进行评估。

9.2 该节点机构将作为项目管理机构（PMA），负责提供秘书、管理和实施支持，并执行（MeitY）不时指派的其他职责。PMA的功能和责任将在MeitY单独发布的计划指南中详细说明。

9.3 为开展与实施SPECS有关的活动，PMA将特别：

9.3.1 接收申请，发出确认书，完成评估，并核实申请人是否符合本计划的资助资格。

9.3.2 审核报销申请，并将奖金发放给批准的申请人。

9.3.3 定期向 MeitY 提交计划进度和执行情况的报告。

9.4 PMA将把经评估合格的申请提交给由电子和信息技术部（MeitY）组成的执行委员会（EC）。执行委员会将由一名不低于联合秘书（MeitY）职级的官员主持。执行委员会将由有关部委和组织的代表组成。执行委员会的详细组成、职能和责任将在方案准则中详细阐述。

9.5 EC将建议PMA批准/拒绝/修改申请。根据EC的建议，PMA应向申请人发出批准函，并将副本发送给MeitY。

9.6 （MeitY）须就支付奖励予已获批准的计划项目的预算拨款。奖励的发放应由PMA根据批准条件及其财务规则进行PMA将定期将预算要求作为合并金额提交给MeitY，而不是逐项提交。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

电子信息技术部

(IPHW 部门)

9.7 该计划的进展将通过一个理事会（GC）进行审查，理事会由（MeitY）组成，由秘书长MeitY担任主席。（GC）将由来自政府和行业的专家组成（GC）将定期审查该计划及其项目的进展情况。（GC）将被授权不时对计划指南进行修订，以成功实施计划。GC的详细组织、职能和责任将在方案指南中详细阐述。

9.8 理事会应不时审查和修订符合本计划激励条件的货物清单以及适用的门槛。

9.9 为了使（SPECS）计划有效运作，MeitY应制定一套评估和支付指南，并单独发布。

9.10 对该方案进行中期评估，以评估工业和经济根据既定目标所获得的效益。

符合SPECS激励条件的货物清单。

A. 最低投资限额为5000万卢比的货物清单。

序号	货物说明
1.	SMT组件，包括LED芯片。
1.	智能卡芯片模块，RFID天线和标签，CoB/系统封装。
2.	电子用无源元件，包括电阻器、电容器、铁氧体等。
3.	电子应用的机电元件，包括变压器、电感器、线圈、继电器、开关、微型电机、步进电机、无刷直流电机、连接器、散热器、天线、扬声器、麦克风等。
4.	电子设备用磁控管、波导、环行器、耦合器、隔离器、滤波器、磁铁、射频元件。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

电子信息技术部

(IPHW 部门)

5.	印刷电路板，印刷电路板层板，预处理，光聚合膜，印刷电路板油墨；印刷柔性电子产品。
6.	电子应用的传感器、传感器、驱动器和晶体。
7.	摄像机模块，可控震源电机/振铃器。
8.	USB/数据线，HDMI线。
9.	SPECS下所有货物的资本货物。

B. 最低投资限额为15000万卢比的货物清单。

序号	货物说明
1.	活性成分： a. 分立半导体器件，包括晶体管、二极管等。 b. 功率半导体，包括场效应晶体管、mosfet、晶闸管等。
2.	石英和光纤预制件
3.	显示屏总成和触摸屏/盖玻璃总成

C. 最低投资限额为25000万卢比的货物清单。

序号	货物说明
1.	微型/纳米电子元件，如微型机电系统（MEMS）和纳米机电系统（NEMS）
2.	装配、测试、标记和包装（ATMP）单元

D. 最低投资限额为75000万卢比的货物清单。

序号	货物说明
1.	电子机械（塑料和金属零件）

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

电子信息技术部

(IPHW 部门)

E. 最低投资限额为25亿卢比的货物清单

序号	货物说明
1.	氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、砷化镓(GaAs)等复合半导体和硅光电器件/集成电路、光电子器件.

F. 最低投资限额为50亿卢比的货物清单

序号	货物说明
1.	半导体晶片

G. 最低投资限额为100亿卢比的货物清单

序号	货物说明
1.	半导体集成芯片 (IC), 包括逻辑[微处理器、微控制器、数字信号处理器 (DSP)、专用集成电路 (ASIC) 等]; 存储器; 模拟/混合信号IC等。
2.	用于电子应用的显示器制造单元, 包括液晶显示器 (LCD)、发光二极管 (LED)、有机发光二极管 (OLED) 等.
